

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
18. Mai 2012 (18.05.2012)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2012/062343 A1

(51) Internationale Patentklassifikation:

G01N 29/04 (2006.01) G01B 17/02 (2006.01)
G01N 29/265 (2006.01) G01B 21/08 (2006.01)
G01N 29/27 (2006.01) G01N 21/95 (2006.01)
G01N 29/275 (2006.01) H01L 21/00 (2006.01)
G01B 7/06 (2006.01) H01L 21/66 (2006.01)
G01B 15/02 (2006.01)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2010/006902

(22) Internationales Anmeldedatum:
12. November 2010 (12.11.2010)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): EV GROUP E. THALLNER GMBH [—/AT];
DI Erich Thallner Straße 1, A-4782 St. Florian am Inn
(AT).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): WIMPLINGER,
Markus [AT/AT]; Braunauerstraße 84, A-4910 Ried im
Innkreis (AT).

(74) Anwälte: SCHWEIGER, Johannes et al.; Becker &
Müller, Turmstrasse 22, 40878 Ratingen (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

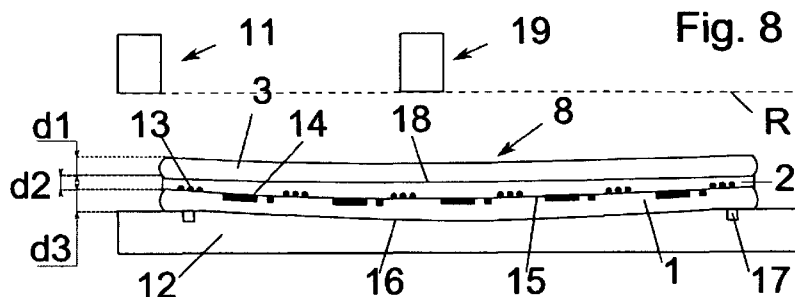
(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz 3)

(54) Title: MEASURING DEVICE AND METHOD FOR MEASURING LAYER THICKNESSES AND DEFECTS IN A WAFER STACK

(54) Bezeichnung : MESSEINRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR MESSUNG VON SCHICHTDICKEN UND FEHLSTELLEN EINES WAFERSTAPELS



(57) Abstract: The invention relates to a measuring device and to a method for measuring and/or detecting layer thicknesses and/or defects in one or more layers of a wafer stack at a multiplicity of measurement points distributed on the wafer stack, and also to a corresponding wafer processing apparatus.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Messeinrichtung sowie ein Verfahren zur Messung und/oder Erfassung von Schichtdicken und/oder Fehlstellen einer oder mehrerer Schichten eines Waferstapels an einer Vielzahl von am Waferstapel verteilten Messstellen sowie eine korrespondierende Waferbearbeitungsvorrichtung.

WO 2012/062343 A1